

LED ジャパン 2013/Strategies in Light

会期:2013年10月16日(水)~18日(金) / 会場:パシフィコ横浜

全光束測定システム



ラブスフェア社のOP-FLUXシリーズは、LED、LED照明、バックライト、ディスプレイ等の全光束やスペクトル、ワット、色度座標、演色評価数等の高精度測定を簡単に行える全光束測定システム。サンプルの形状、配光特性に合わせて $2\pi \cdot 4\pi$ の測定に対応した積分球を直径10センチ~3メートルから選択可能。日本語表示のソフトで容易にシステム校正及び試料ランプの点灯、測定、データの保存まで行える。オプションで、試料ランプの温度をコントロールしランプの温度特性測定が出来る温度制御モジュールや測定規格LM-80の積分球内部温度を一定にする積分球デザイン・温度制御装置も提供。

オーシャンフォトニクス(株) 営業部 ラブスフェア課
☎03-6278-9470
ブース番号:L-169

レンズ拡散板

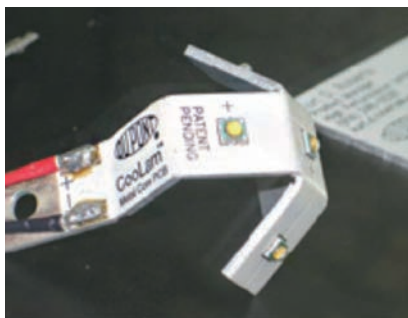
シート表面に施された微小でランダムなレンズアレイにより光を拡散整形し、ムラのないきれいな光に変える拡散板。眩しさの低減などにも効果を発揮し、RGB各色のLED光をきれいに混色させ、必要な範囲にだけ光を配光できるので、効率的な照明を実現できる光学製品である。また、透過率が大変高いため(85~92%)、光



源の光を無駄なく利用することが可能。家庭用、店舗用、舞台用照明をはじめ、検査照明など産業用途も含めたLED照明に多く使われており、レーザー光を用いるアプリケーションも展開している。

(株)オプティカルソリューションズ
☎03-5833-1332
ブース番号:L-192

LED照明用放熱基板材料



絶縁層に極薄ポリイミドを使用し、熱抵抗のパフォーマンスを飛躍的に向上。基板加工時に生じるクラック、及び欠けの懸念は一切なく、製造時の歩留り改善に貢献。

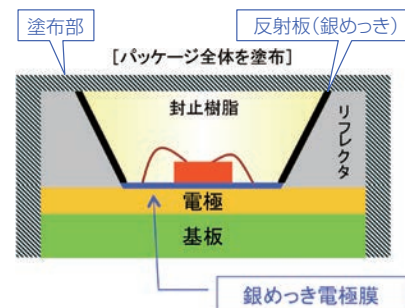
特にCOBタイプの基板に最適な材料で、日本に加え全世界の主要なLED照明メーカーに採用中。

また曲げ加工可能なクーラム™3Dを昨年末に上市。LED照明の懸念であった配光性をクーラム™3Dを活用することによりボードデザインを自由にアレンジし、全方位配光型LED電球の実現に寄与。

通常のLED照明のみならず、意匠性が問われる車載用DRL、省スペース化・部品点数の削減を要するフラットTV用バックライトへの用途に展開中。

デュボン(株) 回路・パッケージ材料事業
☎03-5521-2832
ブース番号:L-177

フッ素コーティング剤



野田スクリーンでは、長年培ったフッ素技術でLEDの硫化による輝度の低下を防止するコーティング剤を開発。

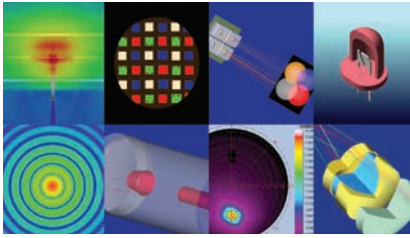
特長は、次の6点。(1)耐硫化性能の高いフッ素皮膜が銀の硫化を防ぎ反射率の低下を抑制。(2)透明性の高い皮膜はLEDのコーティング剤として最適。(3)常温速乾にて強固なフッ素皮膜を形成。(4)各種基材に優れた密着性を発揮する。(5)ディップ、スプレー、ディスペンス塗布が可能。(6)PFOA対策品、PRTR非該当。

用途は、次の2点。(1)LED銀メッキ部の硫化防止。(2)LEDパッケージ及び基板防湿・防滴保護。

(株)野田スクリーン 第二営業部
☎0568-79-0284
ブース番号:L-171

照明光学設計ソフトウェア

LED照明・ディスプレイ・住宅照明など、様々なアプリケーションで幅広く利用されている光学設計ソフトウェアのZemax。より効率的かつ正確に

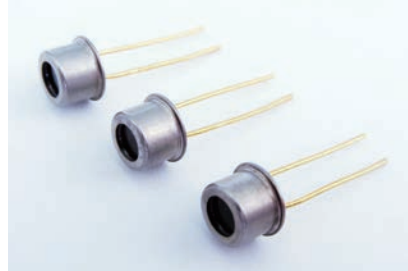


設計開発を行えるよう、光源実測データや散乱実測データをライブラリとして使用できる。また、CADデータの連携も可能であり、すでに持ち合わせているCADデータを有効活用する事もできる。Zemaxは、レンズなどの結像光学設計も可能である点が最大の特徴である。これにより、ヘッドアップディスプレイなどのレンズ設計と照明設計が融合したシステムの設計開

発も一つのソフトウェアで可能。

(株)プロリンクス 営業部 営業第2課
☎03-5256-2053
ブース番号:L-158

深紫外線LED



短波長(255-350nm)、高出力、高寿命、省エネを特徴としたパッケージ・モジュールを提案。紫外線LEDは、

殺菌や除菌、樹脂硬化、各種センサー等に利用可能。水銀フリー・小型・低電圧駆動・パルス駆動・単一波長などの特徴を生かし、設計の自由度を高め、用途の拡大に貢献する。また、パネル展示ではセラミック基板製造装置を紹介し、新規参入・垂直立上げをサポートする独自の製造システムも提案する。

その他に汎用CANパッケージ、高出力SMDパッケージ、高密度実装用SMDパッケージ、各種モジュール、セラミック基板製造システム、LEDセラミックパッケージ基板を紹介する。

日機装(株) クリーンテック機器部
☎03-3443-3732
ブース番号:L-172

LEDJ

高輝度LEDの専門展

LED JAPAN Conference & Expo Strategies in Light.

The Leading Events for the Global LED and Lighting Industry

主催：株式会社 ICS コンベンションデザイン
PennWell Corporation

<http://www.led-japan.com/>

WEB 来場事前登録を受付中
入場料 2,000 円が無料に！

10.16 **水** - 18 **金** 10:00-17:00

パシフィコ横浜 Pacifico Yokohama

[同時開催]

INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS EXHIBITION 2013
InterOpto 2013

BioOpto Japan
2013 Conference + Exhibition

LaserTech 2013

お問い合わせ・お申し込み

LEDジャパン主催事務局 株式会社 ICS コンベンションデザイン
TEL : 03-3219-3643 FAX : 03-3219-3628 e-mail: led@ics-inc.co.jp